***Секция***

**КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ**

Руководитель – *Чуканов В.О.,* профессор кафедры № 12

Секретарь – *Гуров В.В.*, доцент кафедры № 12

Тел. (499)323-92-83

E-mail:ksit2014@ramler.ru

И.Н. БЫЧКОВ, Д.В. ИГНАТОВ1

*ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», Москва*

*1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»*

**ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСИРОВАНИЯ И СБОРКИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРОВ**

Высокопроизводительные микропроцессоры относятся к сложно-функциональным СБИС с большим количеством периферийных интерфейсов: каналов высокочастотной оперативной памяти, ввода-вывода, межпроцессорных соединений и управления. Сложность совместного проектирования периферии кристалла, корпуса микропроцессора и модуля сервера на его основе постоянно растет. Для такого совместного проектирования предложены эффективные методы с учетом различных технологий изготовления корпусов микросхем. Также представлен сравнительный анализ технологических процессов изготовления коммутационных плат корпуса на основе современных полимерных и керамических материалов. Определены преимущества и недостатки этих технологических процессов для сборки высокопроизводительных микропроцессоров.